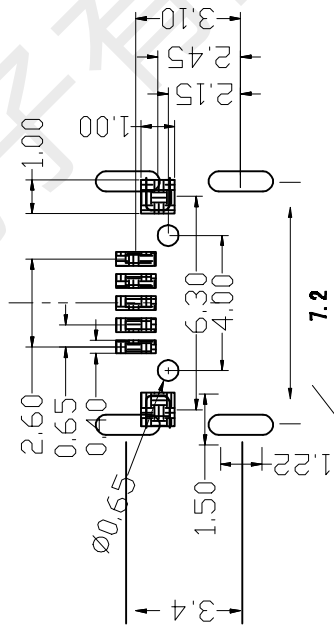
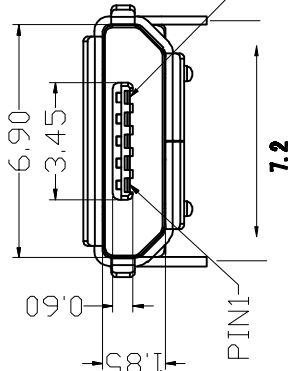
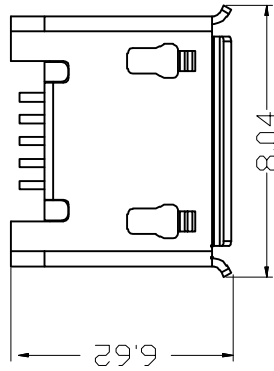
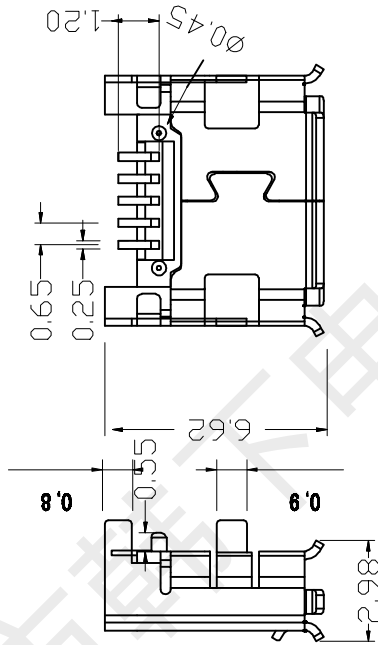
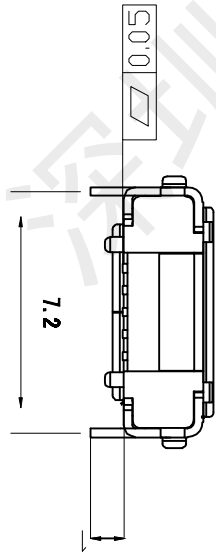


标记 REV. LTR.	日期 DATE	版次 REV.	变更内容 REVISION NOTES
-----------------	------------	------------	------------------------

姓名
NAME



规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force: 3.0kgf (MAX)
Umate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
0.5kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:
High Temperature Thermoplastics,
UL 94V-0 LCP Black
 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 3. 外壳: Shell: H 65
- 电镀: Finish:**
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails
 2. 外壳: Shell:
Nickel Plating (能过炉自动上锡)

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

表面处理 PLATED	料厚 THICKNESS	材料 MATERIAL
----------------	-----------------	----------------

品名 TITLE		料号 P/N	图号 Dwg. No.	图名 Dwg. Name	版次 REV.	单位 UNIT	比例 SCALE
Micro USB		HX MICRO 4P DIP JB				1/1	孔径 FILE NAME
深圳市韩下电子有限公司 SHENZHEN HANXIA ELECTRONICS CO., LTD.		李春风 LI CHUNFENG	钟华华 ZHONG HUAWA	罗孝金 LUO XIAOJIN			



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

Micro USB

规格型号 Part No:

HX MICRO 4P DIP JB

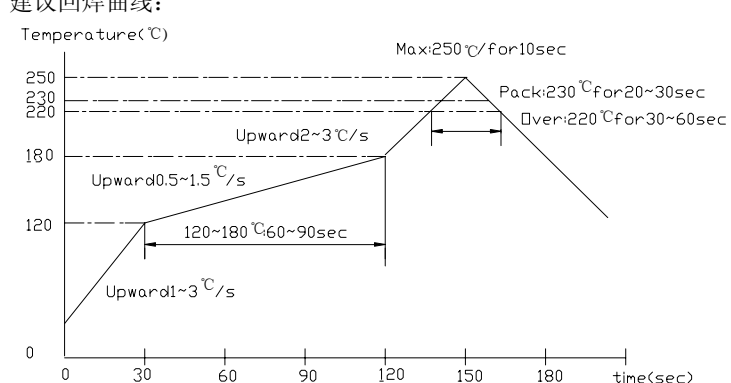
贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	



1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C2680, 镍底, 接触部位镀金 1μ”			
1.3. 外壳部分: H65, 外壳镀镍底 50μ”, 镀锡80μ			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电压电流: 30V 1Ampere			
2.2. 使用温度: -30℃~+80℃			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	50mΩ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	100MΩ MIN 100V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	300V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.0Kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	0.7Kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 5000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 ⁻⁶ 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235±5℃锡炉中浸泡 5±0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于 85℃的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于-40℃的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于温度为 40±2℃, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50mΩ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35±2℃的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C, stays at 120°C for 60~90 seconds, then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, stays at 180°C for 2~3 seconds, then rises at 2~3°C/s to a peak of 250°C for 10 seconds, then falls at 2~3°C/s to 230°C for 20~30 seconds, and finally falls at 2~3°C/s to 220°C for 30~60 seconds.</p>